株式会社東京精密 2026 年度(2027 年 3 月期) 第 2 四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2026 年 11 月 4 日 開催

- *本資料は、上記日時に開催された 2026 年度(2027 年 3 月期)第 2 四半期決算説明会(Web 開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。*
- *本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。*
  - *なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。*

1. 7-9 月期の営業利益率(25.9%)が 4-6 月期(16.1%)から大きく改善している背景は。

- 高付加価値製品の売上増加に伴う売上総利益の改善や、工場稼働率上昇による稼働益が大きいと考える。また販売単価の改定も一定程度寄与していると考える。
- また、計測の 7-9 月期営業利益率が、4-6 月期の 1 桁台から改善しており、これも全社の営業利益率の改善に寄与している。

2. 7-9 月期の SPE 受注高が想定を大幅に上振れた背景を聞きたい。

- AI を含む HPC 向けも堅調で、ロジック・HBM 双方で堅調な引合となった。そのほかの分野も堅調な市況(ディスクリートパワー半導体向けを除く)が続いた。
- また、シリコンフォトニクス分野でプローバの引合はあるが、ダイサの受注が想定以上に強かった。もっとも、製品単価は高くないため、大きな収益改善に寄与するものではない。

3. **7-9 月期の SPE 受注高が想定を上振れたにも関わらず、2026 年度下期業績見通しが前回予想とほぼ同水準で据え置かれている理由を確認したい。**

- 受注高は増加しているが、売上高の増加には、生産スペースの確保・人員の確保、ならびに部材調達の状況を勘案しなければならない。
- 生産面では、プローバの主力工場である飯能工場(埼玉県)に保管している部材を外部倉庫へ移管しそのスペースを生産場所へ転用する取り組みを行っている。
- 人員面では寮の増設を行い、日本全国への採用活動の強化などを行っている。
- 一方で部材調達のリスクは注視すべき状況であり、今回の業績予想(売上高 1,920 億円)は、必要な部材の調達にめどが立っている案件を積み上げて計画している。
- 仮に、部材調達が当社の想定以上に進んだ場合でも、納入のタイミングや生産への展開を鑑みると、売上予想へのアップサイドは数%程度と推定している。

4. **2026 年度下期 SPE 営業利益率が、上期比で改善すると考える根拠を確認したい。**
   - 上期に続き、高付加価値製品の売上増加が期待できるほか、ダイサの売上高が増加することを想定しているため(数量増による利益改善効果)。
   - もっとも、前述の飯能工場に関する外部倉庫コストなど、一定の費用増加があることも留意する必要がある。

5. **2026 年度下期 SPE 受注見通しにおいて、1-3 月期の見込みが、10-12 月期比で減少するように見える背景を確認したい。**
   - 1-3 月期の受注見通しについては、そのタイミング(1-3 月期または 2027 年 4-6 月期のどちらか)やビジビリティが高まらない案件があり見通しづらいため、現時点ではこの想定を置いている。1-3 月期のビジビリティが高まれば、現在の下期見通しを上振れる可能性も否定できない。

6. **2026 年度下期 SPE 受注見通しにおいて、Hybrid Bonding 向けグラインダの事業機会の考え方に変化はあるか。**
   - NAND 向けに 2026 年度下期以降で量産用装置の受注を期待、2027 年度後半からの出荷実現を期待、という想定であったが、やや後ずれする印象を持っている。これは、メモリメーカが、いずれも現世代製品の量産優先度を高めているためではないかと分析している。
   - 従って現時点では、この下期は、評価機として出荷された装置の一部について受注・売上の可能性を折り込んでいる。
   - 当社では各グラインダ生産が増加傾向にあるため、Hybrid Bonding 用グラインダの見通しの後ずれは、むしろグラインダ需要の持続性を更に伸ばすものという視点で考えたい。さらに、今後の Hybrid Bonding 技術の DRAM や光通信アプリケーションへの展開に強く期待をしたい。

7. **2027 年度に向けて、コスト上昇がある中、利益率改善についてどう考えているか。**
   - 引き続き、高付加価値製品の売上構成比の上昇による利益率改善に期待しており、今後数ポイント改善することを期待している。

8. **会社は部材調達の動向を注視しているが、現在 特に逼迫度合いが高いと思われる部材はあるのか。また、今後の対応について聞きたい。**
   - 特定部材よりも、部材全般に逼迫感がみられる状況だ。敢えて例を挙げると、電装基盤や、磁石を使用するモータなどでひっ迫感が強い。

- 当社は今後の調達リスクを勘案し、1 年以上先の部材調達(発注)を行っている。サプライヤ側も直ちに出荷量を増減させることは困難であるため、発注を先んじて行うことが必要部材の確保において重要と考える。
- 部材価格の上昇による利益への影響も考慮する必要がある。当社は、付加価値による価格の提案やコストの転嫁も検討したい。

9. 会社はプローバの生産キャパシティ拡大計画を説明した。これは台数ベースの情報であるが、製品単価はどのように変化すると想定するか。そしてこれは売上高に換算するとどのように考えればよいか。

- 検査すべきデバイスが、高精度を要求するものであれば、その分単価は上昇するとみる。仮に汎用デバイスであっても、温度制御要求がさらに高度化する環境では、単価上昇の傾向は続こう。
- 従って、台数の成長+αの売上高になる可能性は考えられる。

10. 加工装置(グラインダ、ダイサ)の生産キャパシティ拡大はどうか。

- 加工装置のキャパシティ拡大も並行して進めている。特にグラインダは、名古屋工場の稼働率が下期から高まる予定で、2027 年度は一定の売上増加が見込める。
- SPE 全体で、2027 年度のキャパシティは今年度比 20-30%増加が実現できると考えている。

11. 製品価格の改定に関して現状を聞きたい。

- 高付加価値による適切な価格設定は需要拡大も相まって進んでいくと思われる。
- 生産コストの価格への転嫁は、顧客の理解を得られるケースとそうでないケースがあり、実勢として数%の上昇にとどまる。また、納期短縮と連動した価格の改定は、あまり聞いたことがない。

12. 計測の利益率改善に関する考え方を聞きたい。

- 自動車関連業界向けの製品の営業利益率は平均で 14%前後と見積もっているが、AI データセンタや半導体メーカ向けなどは、高精度な計測機器の需要が多く、結果、利益率も高くなる。これらの構成増加による利益率の改善に期待したい。

以上